



kingston.com/epop

ePoP

Giyilebilir Cihazlar için Gömülü PoP (Package-on-Package) Bellek

Kingston ePoP ürünleri, Gömülü Multimedya Kart (e•MMC) veri saklamayı Düşük Güç Çift Veri Hızı (Low-Power Double Data Rate - LPDDR) DRAM'i, bir Package-on-Package (PoP) çözümünde bir araya getiren, yüksek düzeyde entegre bir JEDEC standardı bileşendir. ePoP, doğrudan uyumlu ana cihaz System-on-a-Chip'e (SoC - Çip Üzerinden Sistem) takılarak Baskılı Devre Kartı (PCB) alanını küçültür ve en iyi performansı sağlar. ePoP, giyilebilir cihazlar gibi alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için ideal çözümdür.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Doğrudan ana cihaz SoC'nin üzerine takılan ePoP, giyilebilir cihazlar gibi alanın kısıtlı olduğu küçük form faktörlü uygulamalar için ideal çözümdür.
- Düşük Güç DRAM ve optimize veri saklama yazılımı, pilli giyilebilir uygulamalar için güç tüketimini azaltırken gereken yüksek performansı sağlar.
- Sistem tasarımını basitleştirir, piyasaya çıkış süresini azaltır ve uygunluk onaylama süresini kısaltır.
- Uygulamanızın performans, güç ve kullanım ömrüne yönelik gereksinimlerine en iyi şekilde uyacak birden fazla yazılım yapılandırması mevcuttur.

PAZAR SEGMENTLERİ



IoT



Giyilebilir Cihazlar



Artırılmış Gerçeklik (AR) / Sanal Gerçeklik (VR) cihazları

EPOP PARÇA NUMARALARI VE ÖZELLİKLERİ

LPDDR4x tabanlı ePoP

Parça Numarası	Kapasite		Açıklama		Paket	FBGA	Çalışma Sıcaklığı
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,65	144	-25°C ~ +85°C

LPDDR5x tabanlı ePoP

Parça Numarası	Kapasite		Açıklama		Paket	FBGA	Çalışma Sıcaklığı
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,7	201	-25°C ~ +85°C

